

JPCA検定制度

2016年度 PWBインストラクタ試験 申請書

事務局記入

受検番号

※太枠の中は必須記入事項です。(氏名は楷書で正確に記入して下さい)

フリガナ			生年月日	19	年	月	日
				20	年	月	日
氏名	姓	名	性別	男	女		
自宅住所	〒 -						
社名		所属					
会社住所	〒 -						
電話番号			メールアドレス				
請求書送付先	自宅 会社 (どちらかを選択してください)						

《写真貼付欄》

写真貼付

●写真について

1. サイズ：縦4センチ×横3センチ（縦横共±2mm以内の事）
2. 受検者本人の顔写真（最近3ヶ月以内に撮影した上半身、正面脱帽、無背景、裏面に氏名明記）を剥がれないように貼りつけて下さい。クリップやセロテープでの貼り付けはしないで下さい。
3. この写真は資格証に使用します。

1. 受検希望方式（いずれかにレ）

受検級

1級	2級
----	----

受検方式

A方式：2級電子回路営業士又は2級プリント配線板製造技能士と同位以上の資格を取得している又は、経営等に関する国家資格（技術士、中小企業診断士）の合格者。 取得資格名（ ） ※資格証又は合格証の写しを添付して下さい。 記述試験免除（10,000円 消費税込）
B方式：年齢・学歴・業務経歴等による制限はありません。 免除申請無（15,000円 消費税込）

事務局記入

--

2. 専門分類（業務経験上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）

※複数回答可、1級インストラクタ受検者は大分類の項目を2つ以上選択する。

大分類	半導体プロセス	サブストレート	プリント配線板(リジット・フレキ)			
	設計	製造	実装	品質管理		
	経営	営業	調達	工場設営		
小分類	<p>設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション 等</p> <p>製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）、製造技術（積層プレス、パターン形成、ソルダレジスト等）、生産技術 等</p> <p>実装：電子部品、搭載・接合技術 等</p> <p>品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術 等</p> <p>半導体プロセス：前工程、後工程 等</p> <p>経営：経営管理、生産管理、情報システム 等</p> <p>営業：マーケティング、技術営業 等</p> <p>調達：設備調達、材料・部品調達 等</p> <p>工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計 等</p> <p>その他（ ）</p>					

- ※ ご記入漏れがないようにお願い致します。
- ※ 氏名は、正確且つ丁寧にご記入下さい。
- ※ この申請書の貼付写真・ご記入頂いた個人情報につきましては、検定施行における本人確認、受検者・合格証書・資格証の発行および検定試験に関する連絡、各種情報提供の目的のみ使用いたします。

【送付先】

〒167-0042

東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

一般社団法人日本電子回路工業会 「JPCA検定制度 PWBインストラクタ」受検係

電話：03-5310-2020

メール：sikaku@jpca.org